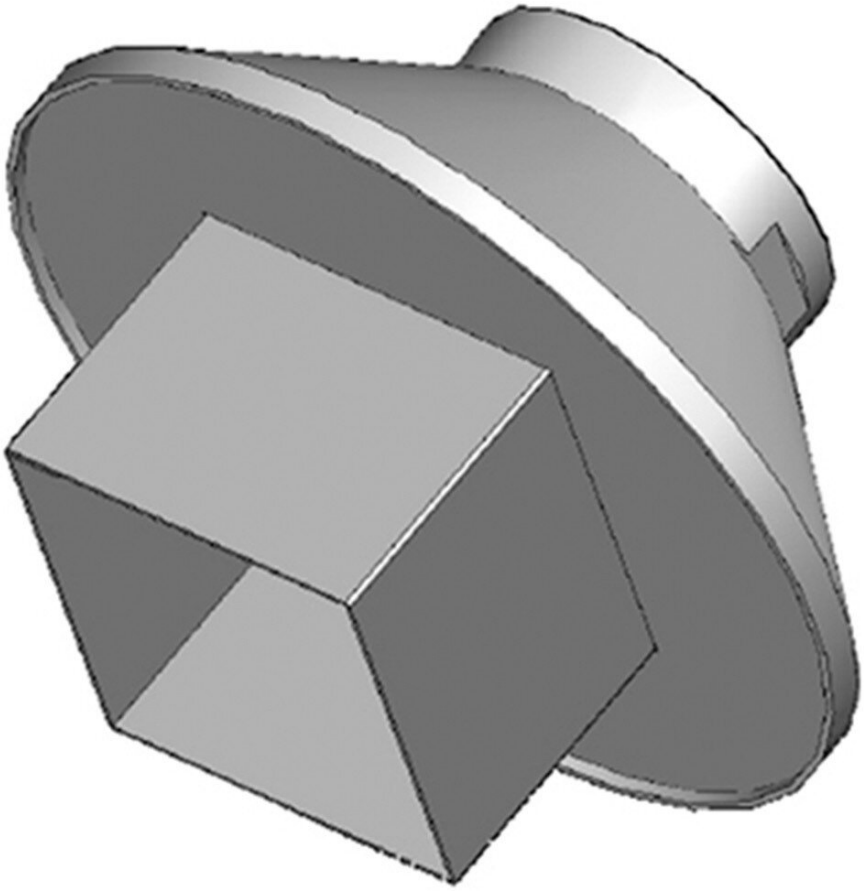
# Dysza kwadratowa 25 x 25 mm do systemu HCT-1000



Dla systemów MRS-1000 / HCT-1000 dostępne są różne dysze gorącego powietrza. Ten wybór dysz umożliwia łatwe usuwanie i wymianę komponentów o różnych rozmiarach, np. BGA, QFP, LGA, PLCC i SOIC. Dysze gorącego powietrza Informacje: Wewnętrzne wymiary dysz gorącego powietrza (długość/szerokość) są o 2 mm większe niż podane rozmiary komponentów w mm. Większe dysze umożliwiają równomierne podgrzewanie komponentów.

| **Numer artykułu.** | **WL26402** |
|---|---|
| Model | HN-B2525 |
| Producent | OKI |
| Numer artykułu producenta. | HN-B2525 |
| Dane producenta GPSR | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford |

| | |
|---|---|
| | GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Nadaje się do | dla systemu HCT-1000 |
| Długość końcówki | 25 mm |
| Szerokość końcówki | 25 mm |
| Zgodny z ESD | nie |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Długość końcówki x Szerokość końcówki |
|---|---|
| WL26153 | 7 mm x 7 mm |
| WL26154 | 10 mm x 10 mm |
| WL26959 | 14 mm x 14 mm |
| WL26401 | 15 mm x 15 mm |
| WL26400 | 21 mm x 32 mm |
| **WL26402** | **25 mm x 25 mm** |
| WL26394 | 27 mm x 27 mm |
| WL26395 | 35 mm x 5 mm |
| WL29108 | 40 mm x 40 mm |